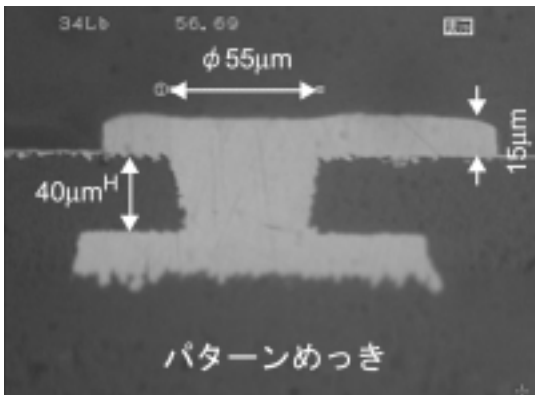
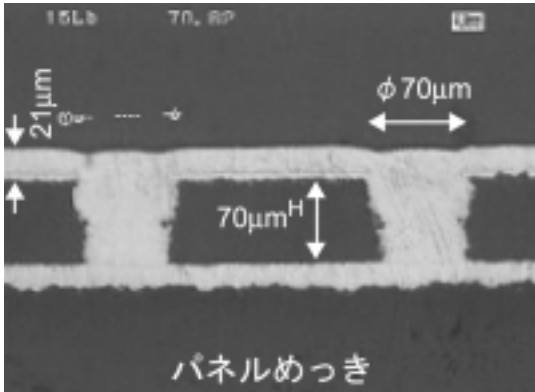


ビルドアップ基板用硫酸銅めっきプロセス CU-BRITE VF-Ⅲ

【特徴】

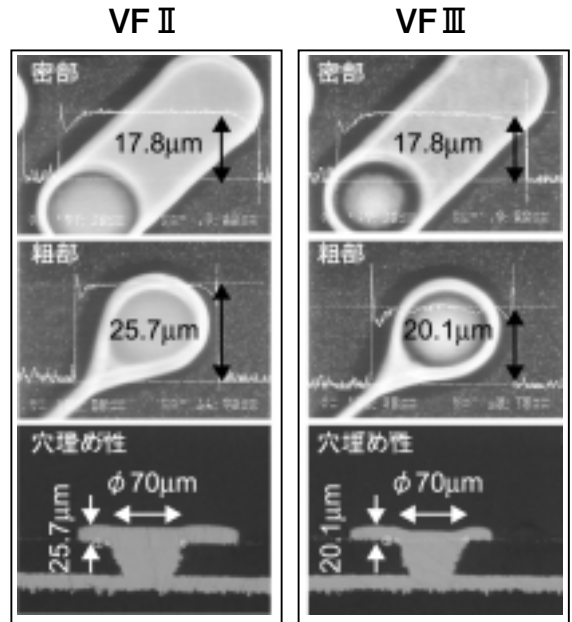
●VFⅢのフィリング性を維持しています。

●パターン面積の粗密差によるめっき厚バラツキを大幅に改善しました。



VFⅢめっき加工実施例
(電流密度：1.5A/dm²)

- スルーホール混在基板にも対応できます。
- 添加剤は2液性で、弊社が開発した分析法により数値管理ができます。
- カートリッジ活性炭処理により、更新無しで使用できます。



2A/dm²50min(膜厚：20μm)

パターン粗密による膜厚比の比較

	粗(μm)	密(μm)	密/粗
VFⅡ	25.7	17.8	0.69
VFⅢ	20.1	17.8	0.89

- 皮膜物性をさらに向上させました。
 伸び率：20%以上
 抗張力：30kg以下
 硬度：100~120Hv



荏原ユーザライト株式会社
EBARA UDYLITE CO., LTD.

本社
〒110-0016 東京都台東区台東4-19-9 山口ビル7
TEL：03-3835-2951 FAX：03-3836-9264
URL：http://www.eu.ebara.com